

公益社団法人砥粒加工学会 研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会 第3回研究会【先端デバイス製造のための研磨・CMPの最前線】開催ご案内

主催：(公社) 砥粒加工学会 研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会
共催：金沢工業大学 FMIT 研究所

2015年2月、(公社) 砥粒加工学会に「研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会」が設立されました。本専門委員会では、「温故知新」の名言に倣い、研磨の歴史・ノウハウ・技術伝承の在り方を探り、そこから次代に向けた課題の明確化とその解決手法開発に取り組むことを目指します。第3回研究会を【先端デバイス製造のための研磨・CMPの最前線】と題して開催いたします。多数の皆様のご参加をお待ちしています。



略称: KENMA 研究会

日 時：2015年11月25日(水) 13:00~18:30
(研究会・・・13:00~17:00, 情報交換会・・・17:00~18:30)

開催場所：金沢工業大学 KIT 虎ノ門大学院 (愛宕東洋ビル 11F)
【「虎ノ門ヒルズ」の隣のビルです】

〒105-0002 東京都港区愛宕 1-3-4 愛宕東洋ビル 11F&12F&13F
(TEL : 03-5777-2227)

http://www.kanazawa-it.ac.jp/about_kit/access.html#anchor06 (アクセスマップ)

東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩8分
都営地下鉄三田線 御成門駅 徒歩8分 JR山手線 新橋駅 徒歩15分



委員長 畷田道雄 (金沢工業大学)

内 容：

「テーマ：先端デバイス製造のための研磨・CMPの最前線」

13:00~13:10 開会挨拶

13:10~17:00 話題提供

<技術講演>

1) 13:10~13:45 コロイダルシリカの研磨特性~シリカ粒子特性と研磨速度~

日産化学工業株式会社 境田広明 氏

2) 13:45~14:20 研磨布の役割と開発に対する考え方

ニッタ・ハース株式会社 羽場真一 氏

3) 14:20~14:55 ポリシングパッド表面性状の机上測定・評価装置「PSP-100」による「見える化」技術とその応用

不二越機械工業株式会社 澁谷和孝 氏

14:55~15:15 休憩

4) 15:15~15:50 研削とCMPが融合したTSV装置

岡本工作機械製作所株式会社 山本栄一 氏

<特別講演>

5) 15:50~16:45 半導体デバイスCMPプロセス並びにCMP装置の概要と将来展望

株式会社荏原製作所 檜山浩國 氏

16:45~16:50 閉会の挨拶

副委員長 會田英雄 (並木精密宝石株式会社)

17:00~18:30 情報交換会 (軽食を準備します)

参加費：6,000円 (情報交換会・ノンアルコール形式を含む)。当日徴収致します。会場は金沢工業大学 KIT 虎ノ門大学院の会議室です。

※情報交換会終了後には場所を移し「拡大技術交流会 (会費：4,000円)」を開催します。合わせてご参加ください。※

参加申込締切：平成27年10月30日(金)

参加申込先並びに問合せ：金沢工業大学 工学部 機械工学科 畷田道雄

TEL : 076-248-1100 FAX : 076-274-7072 E-mail : uneda@neptune.kanazawa-it.ac.jp

※出来る限りメールでお申し込みください※

KENMA 研究会「第3回研究会」参加申込書

氏名			
勤務先・所属			
参加内容 (参加されるものに○を付けて下さい)	研究会 (情報交換会含む)		拡大技術交流会 (会費：4,000円)
連絡先	住所		
	TEL	FAX	
	E-mail		